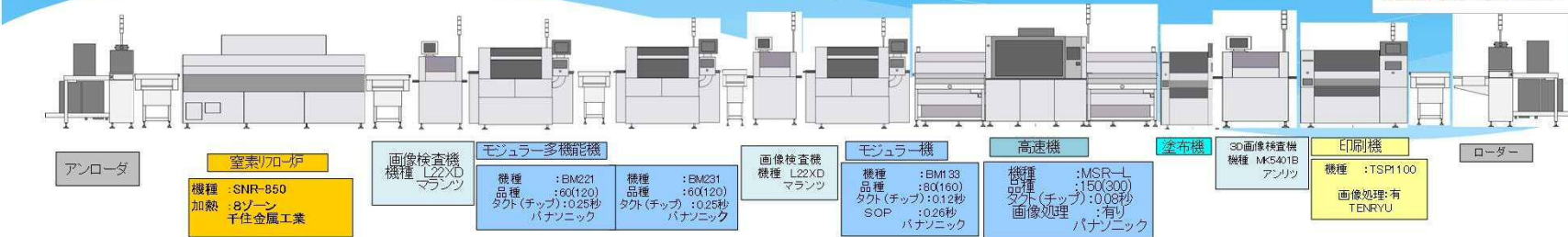


実装設備一覧：大和本社工場

2014.1.1 Rev1

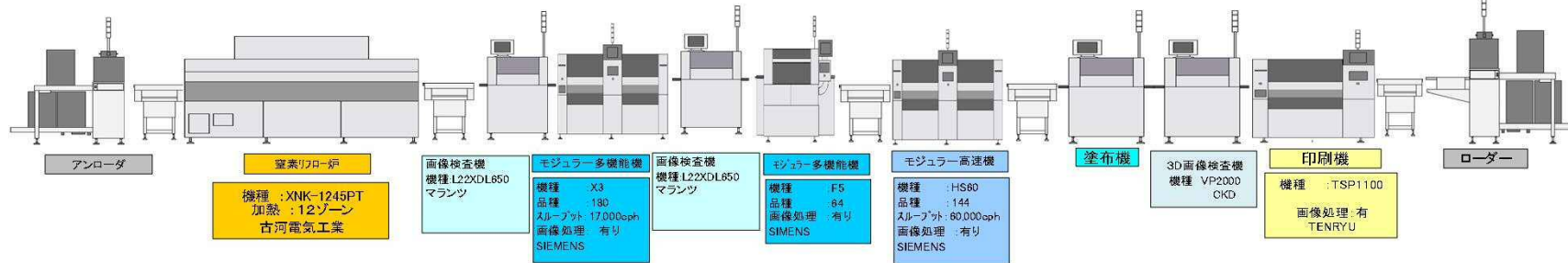
基板サイズ:460*510

1号機ライン



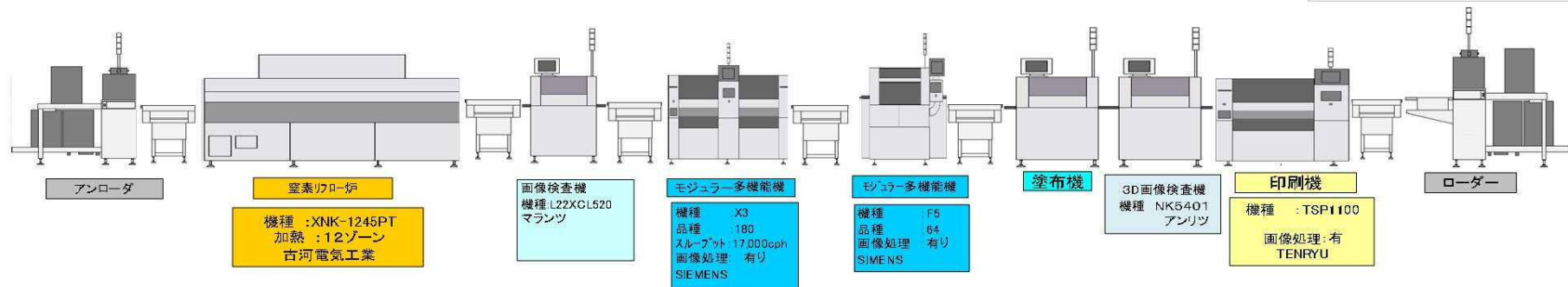
基板サイズ:460*526

2号機ライン



基板サイズ:460*610

3号機ライン



実装設備一覧：詳細（大和本社工場）

◆主要設備一覧					
表面実装部品実装設備					
装置名	型式	メーカー	合計	基板サイズ	備考
クリーム半田自動印刷機	TSP-1100	天竜精機	2台	50×50mm～ 460×600mm	
	TSP-1100	天竜精機	1台	50×50mm～ 460×524mm	
高速チップマウンタ	X3	シーメンス	1台	50×80mm～ 460×610mm	チップサイズ 0402対応 ※専用フィーダー、ノズル
	HS60	シーメンス	1台	50×110mm～ 460×610mm	
	HF3	シーメンス	1台	50×80mm～ 460×610mm	
異形マウンタ	F5	シーメンス	2台		
接着剤塗布装置	HDF	Panasonic	1台	50×50mm～ 460×550mm	
	470D	Universal	1台	50×50mm～ 460×550mm	
	HDP-G3	Panasonic	1台	50×50mm～ 250×330mm	
クリーム半田印刷後検査装置	MK5401B	アンリツ	2台	50×50mm～ 250×330mm	3Dレーザーシステム
	VP2000	CKD	1台	50×50mm～ 460×510mm	3Dレーザーシステム
高速チップマウンタ	MSR-L	Panasonic	1台	50×50mm～ 460×510mm	チップサイズ 0603対応 0.08秒/個
異形マウンタ	BM133	Panasonic	1台	100×50mm～ 460×650mm	
	BM231	Panasonic	1台	100×50mm～ 460×650mm	
	BM221	Panasonic	1台	50×50mm～ 250×330mm	
リフロー炉	XNK-1245PT	古河電気工業	2台	50×80mm～	窒素(N ₂)リフロー 8ゾーン以上
	SNR-850	千住金属	1台	400×600mm	

主要設備一覧：詳細（大和本社工場）

◆主要設備一覧					
検査設備					
装置名	型式	メーカー	合計	基板サイズ	備考
22XDL	D650	マランツエレクトロニクス	2台	50×50mm～ 460×650mm	※実装ライン設置
22XDL	D520	マランツエレクトロニクス	1台	50×50mm～ 460×520mm	
22X H-MA	650L	マランツエレクトロニクス	1台	50×50mm～ 460×650mm	
22X H-MA	800L	マランツエレクトロニクス	2台	50×50mm～ 460×800mm	
◆主要設備一覧					
生産設備					
装置名	型式	メーカー	合計	基板サイズ	備考
基板洗浄機	TC-MS-104	タイセイリソニック	1台	50×50mm～ 460×650mm	洗浄液 旭硝子製 AK225AES
基板分割機	SAM-CT23N	サヤカ	1台	50×50mm～ 250×350mm	分割精度 ±0.01mm 切断ストレス 300μ□
	T-MD2	TST	1台	Y-200mm	Vカット基板専用
	T-MD4	TST	1台	Y-400mm	Vカット基板専用
	T-ME25	TST	1台	Y-250mm	Vカット基板専用
	Hektor2	Cab	1台	50×50mm～ 250×350mm	基板厚 2.5mm カットアウト幅1.0～3.0mm
ポイント噴流半田付け装置	TAKUROBO-NEO-L	弘輝テック	2台	50×50mm～ 380×460mm	PBF 1台 共晶 1台
局部半田装置	TOP-375	テクノデザイン	3台	50×50mm～ 300×400mm	ノズル固定型
◆主要設備一覧					
特殊生産設備					
装置名	型式	メーカー	合計	基板サイズ	備考
コネクタ圧入機		富士コトロール	1台	奥行 150mm	C型アーム
コネクタ圧入機		JAM	1台	奥行 180mm	C型アーム
基板コーティングブース		パーカーエンジニアリング	3台	50×50mm～ 600×800mm	
リワーク装置	Sumit-1100		1台	50×50mm～ 600×800mm	PBF対応可能